

FUDE
复德科技

致力于提供世界一流的半导体封测设备

FUDE
复德科技

致力于提供世界一流的半导体封测设备

深圳市复德科技有限公司

SHENZHEN FUDE TECHNOLOGY CO.LTD.

总部地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6099号

生产基地：广东省东莞市长安镇中南南路科谷工业园7栋B座3楼

电话: 0769-85536006 13902987794 传真: 0769-85536001

邮箱: sales@fude-t.com

网址: www.fude-t.com

- 深圳市高新科技企业
- 广州市半导体行业协会单位
- ISO9001质量体系认证企业
- 中国半导体行业协会分立器件分会单位

COMPANY PROFILE

公司简介

复德科技是国内专业的半导体封测设备公司，自2005年开始半导体封测设备的研发与制造，主营产品编带、测试、分选、打标一体机，目前FD1850机型已达到每小时可完成50K的检测量。复德致力于提供品质一流的半导体封测设备，能提供SOT、SOD、QFN、DFN、SOP、TO等各系列的测试、分选一体机设备。

复德团队

复德科技成立于2013年，由远望工业的半导体设备事业部股份改造而成（2005年成立），员工160名，研发工程师50名；远望工业自动化是一流的自动化设备公司，成立于2004年，在自动化领域无所不精，总员工430名，研发工程师160名。

50 名

研发工程师

160 名

员工



- 深圳市高新科技企业
- 中国半导体行业协会分立器件分会单位
- 广州市半导体行业协会单位
- ISO9001质量体系认证企业

- ▶ 总部位于深圳市宝安区福永街道，生产基地位于东莞市长安新区，海陆空交通极为方便。
- ▶ 复德科技吸取众家之长再加上本身在自动化设备领域的独擅技术制造出独具优势的半导体器件测试分选编带一体机，目前已销售几百台，为众多客户创造价值。
- ▶ 作为独立的自动化设备供应商，公司立足深圳，在全国多个工业城市如广州、上海、扬州、武汉、成都、长春、西安、天水、滁州建立了办事处，为客户提供零距离的即时化供货与售后服务。
- ▶ 公司已进入众多企业的采购体系，为客户提供超越期望的产品与服务，追求完美、持续改进、为您所想、做您所需既是公司的质量方针更是公司对所有客户的郑重承诺。



4

ADVANTAGE

大优势



01

产品优势

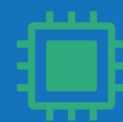
多样性：能提供SOT、SOD、QFN、DFN、SOP、TO等各系列封装IC的测试分选设备；全功能：封装行业的龙头企业我们产品都有提供服务，能适应中外资企业不同的功能需求。



02

市场优势

复德科技吸取众家之长，再加上本身在自动化设备领域的独擅技术，制造出独具优势的半导体器件测试分选编带一体机。目前已销售五百多台，为众多客户所喜爱，长电科技、华天科技、乐山无线电、扬杰科技、富满电子等等均为主要客户。



03

技术优势

在该领域已获得多项专利，无论从技术的深度、广度、难度上来说都已处于国际同行业的领先地位；高速度：UPH>50+@30ms Test Time 高稳定性：MTBA>2hs 全功能：双编带，6套视觉，自动补料，SECS/GEM, GPIB/ TTL/ RS232测试方式。



04

管理优势

作为独立的自动化设备供应商，公司立足深圳，在全国多个工业城市如广州、上海、扬州、武汉、成都、长春、天水、滁州建立了办事处，为客户提供零距离的即时化供货与售后服务。公司已进入众多企业的采购体系，为客户提供超越期望的产品与服务。

为什么选择复德



国内规模宏大，业内技术领先

中国规模宏大的半导体封测设备供应商，自2005年开始研发制造，无数代的技术提升，目前处于国际同行业的领先地位。

高速稳定运行，种类多产能高

致力于提供世界一流的设备，已达到50K的UPH，能提供SOT, SOD, QFN, DFN, SOP, TO等各系列，高速度，高稳定运行，实现高产能。

配件优质价格低，设备性价比高

耗材价格低，运营成本低。强大的自主设计研发能力，高质量的材料，加制造工艺精湛，上乘品质，极具性价比。

多功能易操控，兼容广易扩展

满足多功能场景需求，简洁界面，实时观测运行，可做任何扩展，Vision可扩6个，测试站可扩8个，遍带可扩2个，可扩展编带与料管出料。

制造研发能力强，质量管控体系健全

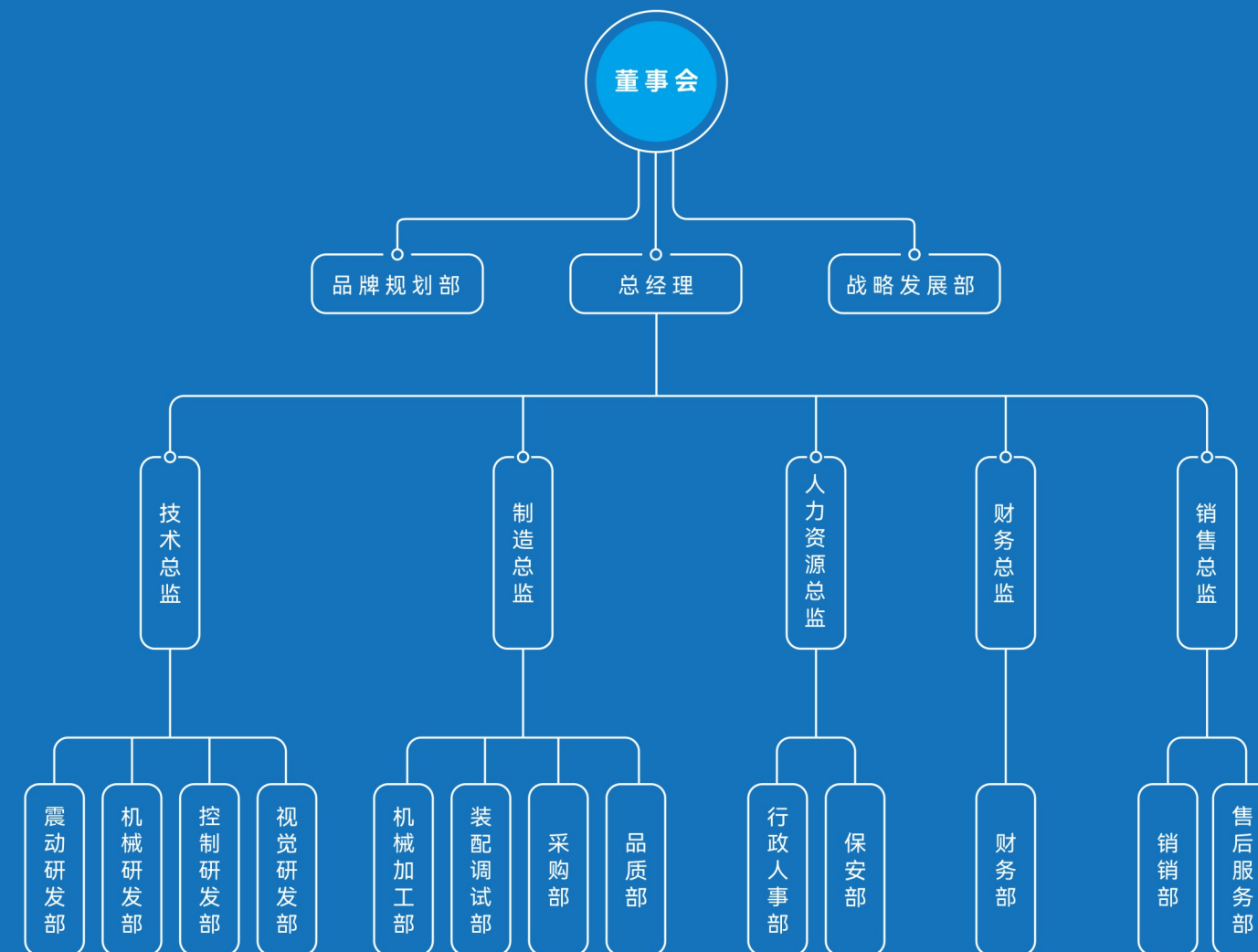
研发团队强大,工程师50名，精密机械制造能力经验丰富,工艺环节完善，生产部下设制造部、电工部、电子部、焊接部、品质控制部。

广泛客户认可度，交货快服务周到

十多年的行业积淀，已有几十家用户使用，客户认可，完善的售后体系，几十人的售后人员，已在各地设立办事处，做到对客户的最快响应。

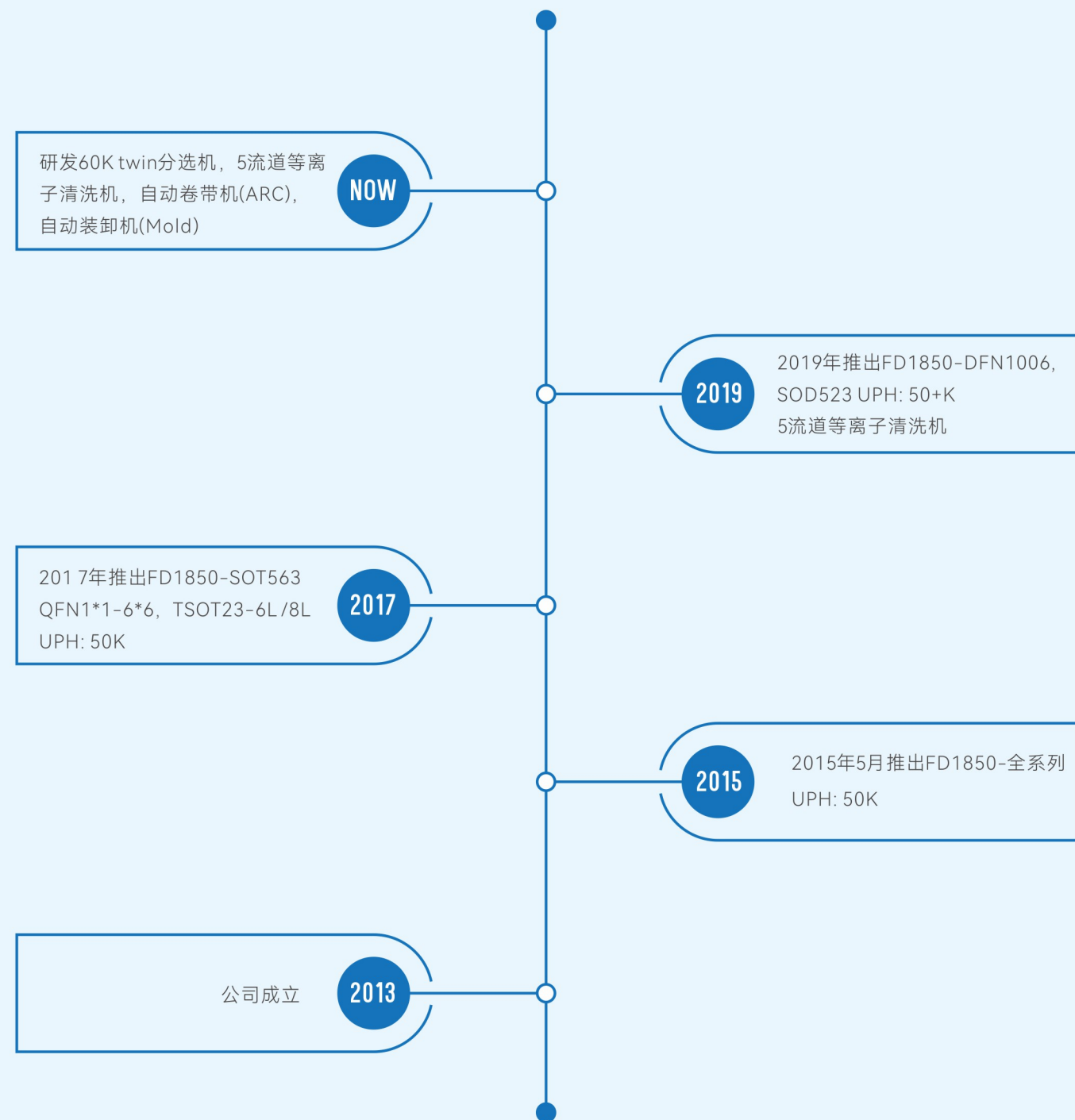
组织结构

复德拥有稳定科学的管理体系，和健全的质量管控体系



DEVELOPMENT HISTORY

发展历程



COOPERATIVE PARTNER

合作伙伴

“为您所想，做您所需”是我们的服务宗旨



售前

充分了解客户需求提供
可行性方案



售中

项目化管理, 严格按照项目
日程表实施生产



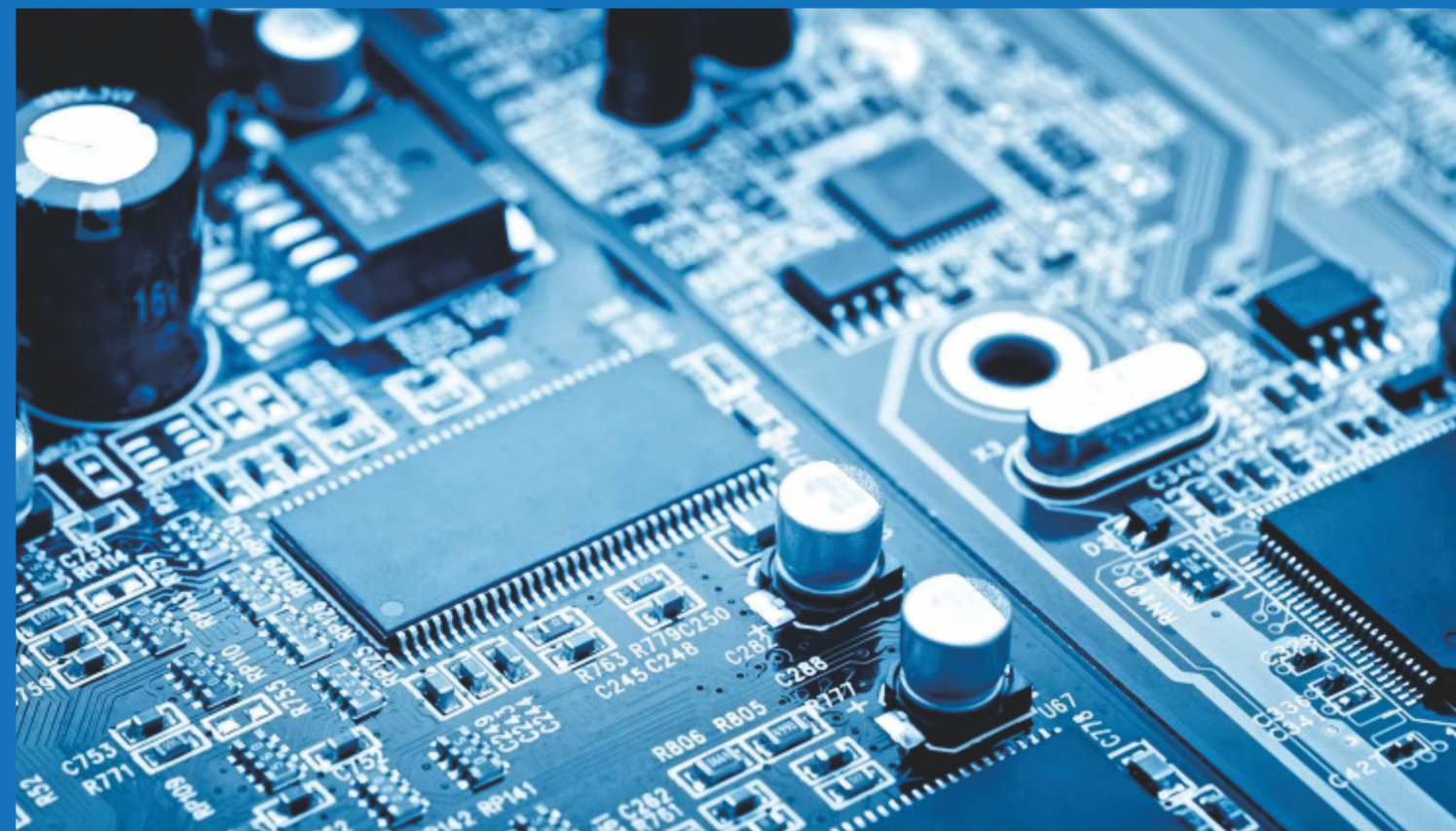
售后

高效快捷的售后服务

MAIN BUSINESS

主要业务

复德科技是拥有一支技术经验领先于同行业的研发、生产、销售以及售后服务团队。为客户提供IC材料转塔式高速自动化测试分选封装设备以及PLASMA等离子清洗机设备。公司本着研发高速、高端、高品质的设计理念，专业致力于半导体/IC前后段制程设备的研发和生产，在半导体测试封装领域拥有客户的高度认可！是目前国内领先的半导体与IC产品自动化设备研发生产的高新技术企业。



01

HANDLER

FD Handler 测试分选打标统带一体机。



02

PLASMA

Plasma Cleaner 高效率等离子清洗机。



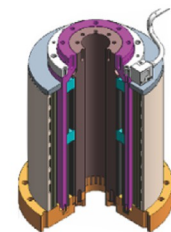
03

ARC

半导体芯片全自动高效率收带机ARC。

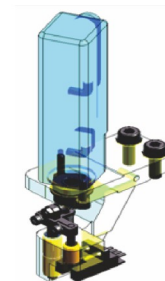


产品优势



主旋转DDR马达

NIKKI DENSO DDR 马达提供更高的力矩/力量比，达到行业内更快的运转速度和高精度。



独立下压马达（Z轴）

YASKAWA 高速度的独立Z轴下压系统提供快速和稳定的下压上升动作，并具有马达力量0.5kg-7kg精准度 $\pm 10\%$ 以内的力矩控制功能。



耗材

- 提供全行业低价优质的耗材
- 让用户的运营成本降低
- 全行业高效快速的耗材提供时间

FD1850/2050

测试分选打标统带一体机

- 型号: FD1850/2050
- 适用于: SOT、SOD、QFN、DFN
- UPH:50K

FUDE
复德科技



FD1850/2050 (Turret Based Test Handle)

设备类型

18 Position Turret System (精度+/-10um)

封装

SOT23, SOT26, SOT223, SOT523, SOD123, QFN1*1-6*6, DFN1006, SOT023, SOT323, SOT346, SOT353, SOT363, SOT457, SOT223, SOT523, SOT563, SOT89, SOD123, SOD323, TSOT236/8L

规格

UPH:>=50,000(测试时间<= 30ms)	MTBA>120Min MTBF>168H
Input:Bowl Feeder	Output:Tape and Reel(Hot Seal)
Test Site:Up to 4	Reject:Binning
控制器: 工业级电脑 with WIN7 OS	

激光打标

CO2,Fiber Laser

视觉系统

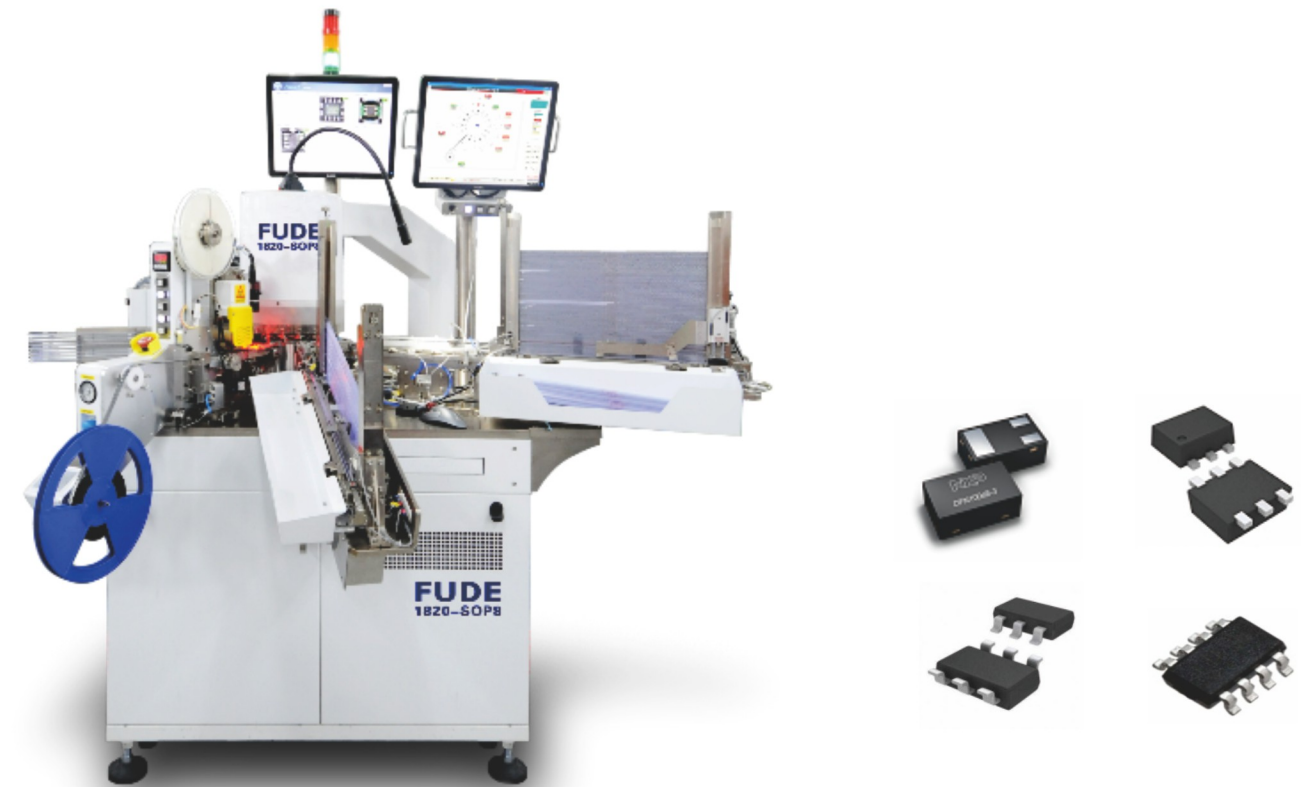
Orientation,Mark,Lead2D, 3D,5S and In-Pocket Inspection

FD2420

测试分选打标统带一体机

- 型号: FD2420
- 适用于: SOP、TSSOP、TO系列
- UPH: 20K

FUDE
复德科技



FD2420 (Turret Based Test Handle)

设备类型

24 Position Turret System (accuracy+/-10um)

封装

QFN, TSOP, TSSOP, SOIC, MSOP, SMA, B and C, Resistor and Glass Diodes, TO252

规格

UPH:>=20,000	MTBA>120Min MTBF>168H
Input:Bowl Feeder	Output:Tape and Reel(Hot Seal)
Test Site:Up to 8	Reject:Binning
控制器: 工业级电脑 with WIN7 OS	

激光打标

CO2,Fiber Laser

视觉系统

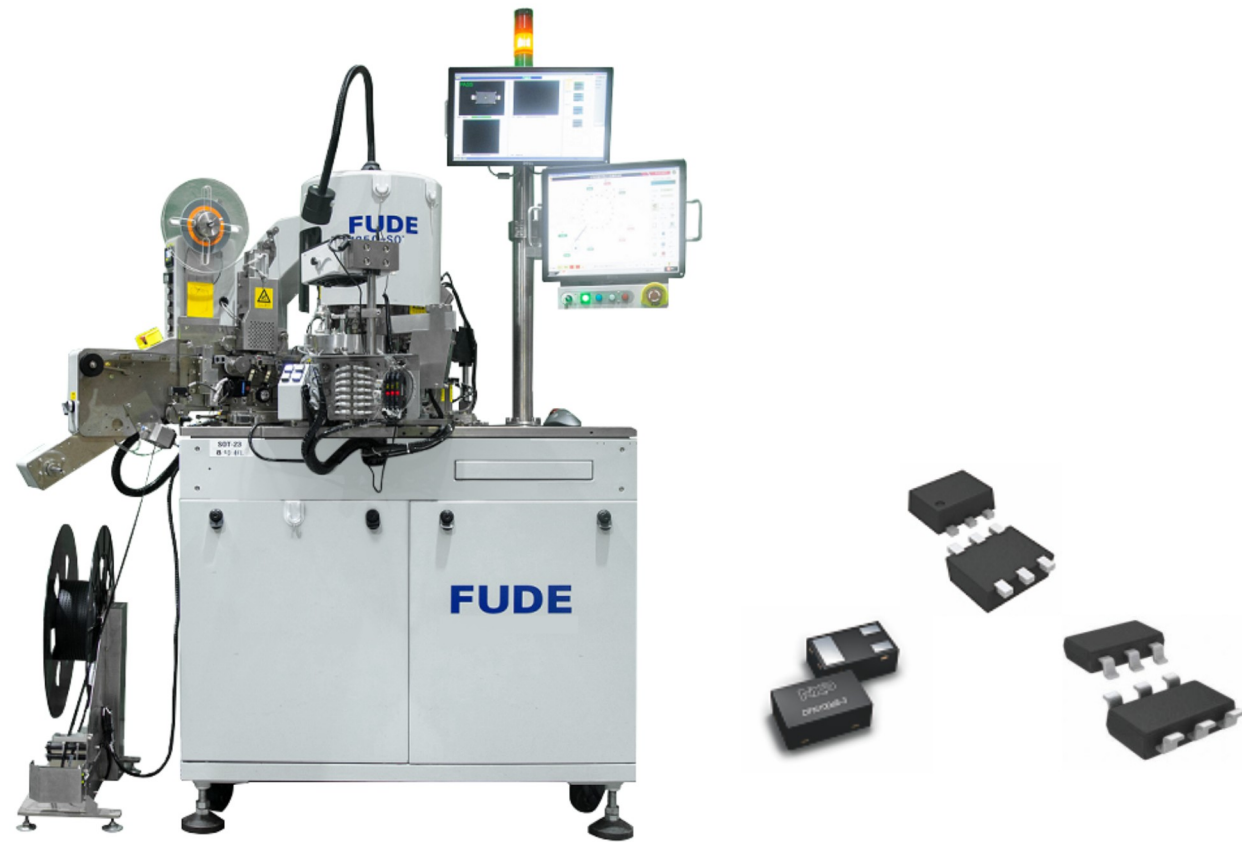
Orientation,Mark,Lead2D, 3D,5S and In-Pocket Inspection

FD2020

测试分选打标统带一体机

- 型号:FD2020
- 适用于:QFN,SOIC、TO系列
- UPH:20K

FUDE
复德科技



FD2020 (Turret Based Test Handle)

设备类型

20 Position Turret System (精度+/-10um)

封装

SOT23, SOT26, SOT223, SOT523, SOD123, QFN1*1-6*6, DFN1006, SOT023, SOT323, SOT346, SOT353, SOT363, SOT457, SOT223, SOT523, SOT563, SOT89, SOD123, SOD323, TSOT236/8L

规格

UPH:>=20,000	MTBA>120Min MTBF>168H
Input:Bowl Feeder	Output:Tape and Reel(Hot Seal)
Test Site:Up to 8	Reject:Binning
控制器: 工业级电脑 with WIN7 OS	

激光打标

CO2,Fiber Laser

视觉系统

Orientation,Mark,Lead2D, 3D,5S and In-Pocket Inspection

PLASMA CLEANER

高效率等离子清洗机

FUDE
复德科技



Plasma Cleaner 高效率等离子清洗机

射频电源	F13.56MHz、1000W (连续可调)
真空度	<15 Pa 无油泵
清洗产品范围	180~280mm X 25~90mm (长x宽)
传递盒尺寸范围	180~290mm X 25~93mm (长x宽)
流道数量	5条, 可选择同时加工五种不同宽度的产品
等离子激发清洗时间	5 Sec
UPH	600 (射频时间为10S, 5条流道时)
清洗能力	水滴角测试 <12°
电源	AC 380V 5.5kw
压缩气体	5-8 bars 50L/min
氩气	3 bars 1 L/min
氮气	3 bars 20 L/min
外形尺寸及重量	(L)×(W)×(H):1600mm×1050mm×1800mm /700kg

ARC40

全自动高效率收带机

FUDE
复德科技



ARC40全自动高效率收带机

项目	规格	备注
卷盘规格	7/13寸	卷盘边缘需有载带插入侦测孔
适用产品型别	需客户指定	-
卷盘放置量	30盘	-
电源	1P220V/1o3w/50Hz	-
气压	5kg/cm ² 以上	饱和压力
操作介面	触控荧幕	-
控制	PLC及人机	-
速度	满足测试包装机速度	-
稼动率	95%	-
外观尺寸	长700*宽750*高1800 (mm)	依实体为准
颜色	红海蓝	-
重量	约150kg	-